

关于半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地项目 申请参与企业投资承诺制改革试点的函

北京经济技术开发区行政审批局：

我公司属于《国民经济行业分类代码表》C 类制造业中的 34 “通用设备制造业”：348 “通用零部件制造”，3489 “其他通用零部件制造”企业，注册地北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼三层 201-3，根据公司发展需求，拟在北京经济技术开发区 0606 街区 YZ00-0606-0014-2 地块新建半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地项目。该项目位于北京经济技术开发区 0606 街区 YZ00-0606-0014-2 地块，该地块用地面积为 25694.7 平方米，容积率 1.36，用地性质工业用地，拟建集成电路装备零部件精密机加车间、表面处理车间、组装车间、检验中心和仓储中心，并搭建智能信息化管理平台，建成国内一流的半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地。项目主要生产腔体、内衬、匀气盘等集成电路装备核心零部件，达产后，实现年产值 7.6 亿元人民币，税收 1000 万元人民币。项目预估总投资为 5.1 亿元，资金来源为企业自筹，项目拟于 2020 年 11 月开工，计划竣工时间为 2022 年 11 月。

在上述项目建设过程中，我公司自愿申请参与北京经济技术开发区企业投资项目承诺制改革试点，并对有关情况作出如下承诺：

一、遵守国家法律法规，严格按照北京市土地利用规划、城市总体规划，开发区产业政策及准入标准、资源开发、能



耗与环境以及交通、水务、园林、节能、人防、安全生产管理等要求，依法、依规开展项目建设工作。

二、我公司将按照承诺书承诺的建设地点、建设规模、建设内容以及相关技术指标，组织实施开工建设。我公司对所提供材料的真实性负全部责任，所有申请材料真实、合法、准确、有效。

三、我公司充分了解企业投资承诺制相关文件精神，以及北京经济技术开发区土地使用权退出机制等管理机制，严格遵守我公司与北京经济技术开发区签订的协议以及承诺约定的相关内容，自愿接受项目全过程监督检查及执法管理，服从相关部门管理，主动接受社会监督。

四、若承诺书内容发生《企业投资项目承诺制改革试点工作实施细则》相关条款规定的重大变化，我公司承诺按照该文件规定，开展后续的变更、重新审批等工作。

项目公司（公章）：

法定代表人（签章）：

2020年11月23日